

2009年3月期 第2四半期 決算概要

2008年10月29日

NECエレクトロニクス株式会社
代表取締役社長 中島 俊雄

<http://www.necel.com/ir/ja/>

- 2009年3月期 上期(4-9月期)業績は、想定に対し円安に推移したものの売上高はほぼ期初の想定どおりに留まり、営業利益は黒字を確保したが、**前回想定(7/30)より悪化**
- 2009年3月期 下期および通期の期初予想を下方修正したが、**下期・通期営業黒字化を目指す**
- **生産体制再編の加速をはじめとするコスト削減施策を実行**

I. 2009年3月期 第2四半期 業績概要

II. 2009年3月期 通期業績見通し

I. 2009年3月期 第2四半期 業績概要

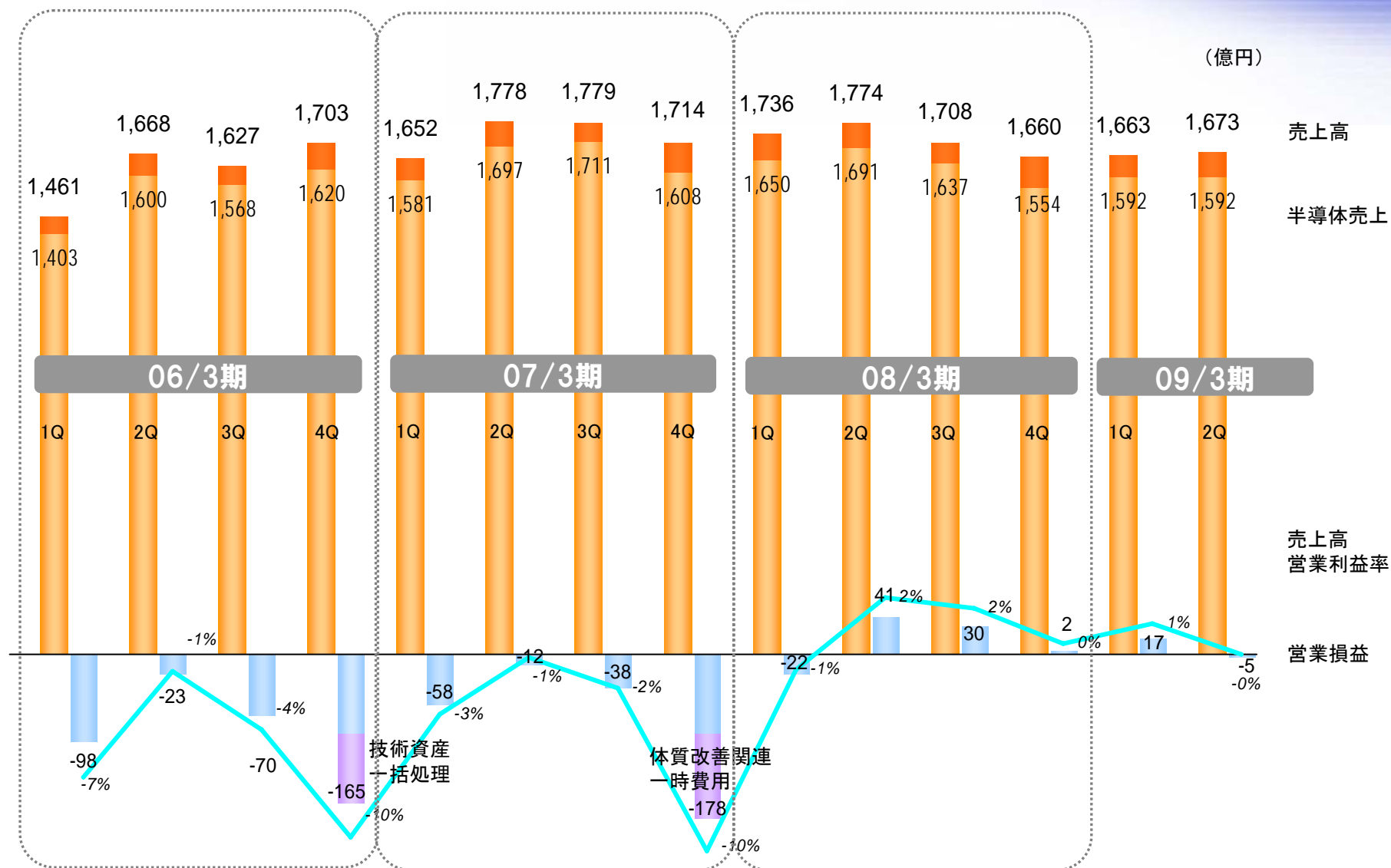
II. 2009年3月期 通期業績見通し

業績サマリ

(単位:億円)	09/3期				
	1Q, 6/30	2Q, 9/30	上期, 9/30		
	実績	実績	実績	前年同期比	前下期比
売上高	1,663	1,673	3,336	△174	△32
半導体売上	1,592	1,592	3,184	△157	△8
営業損益	17	△5	12	△6	△20
税前提損益	3	△3	△0	△18	+51
当期純損益	△13	△6	△19	+11	+111
フリーキャッシュフロー	△67	21	△45	△148	+3
D/Eレシオ	0.51倍	-	0.52倍	-	-
株主資本比率	37%	-	36%	-	-
為替レート	1US\$=103円 1Euro=160円	1US\$=108円 1Euro=166円	1US\$=105円 1Euro=163円	対US\$ △15円 対Euro +1円	対US\$ △7円 対Euro +2円

注: 当社は米国会計基準を採用しておりますが、「営業損益」は売上高から売上原価、研究開発費、販売費および一般管理費を差し引いたものです。

四半期別業績推移

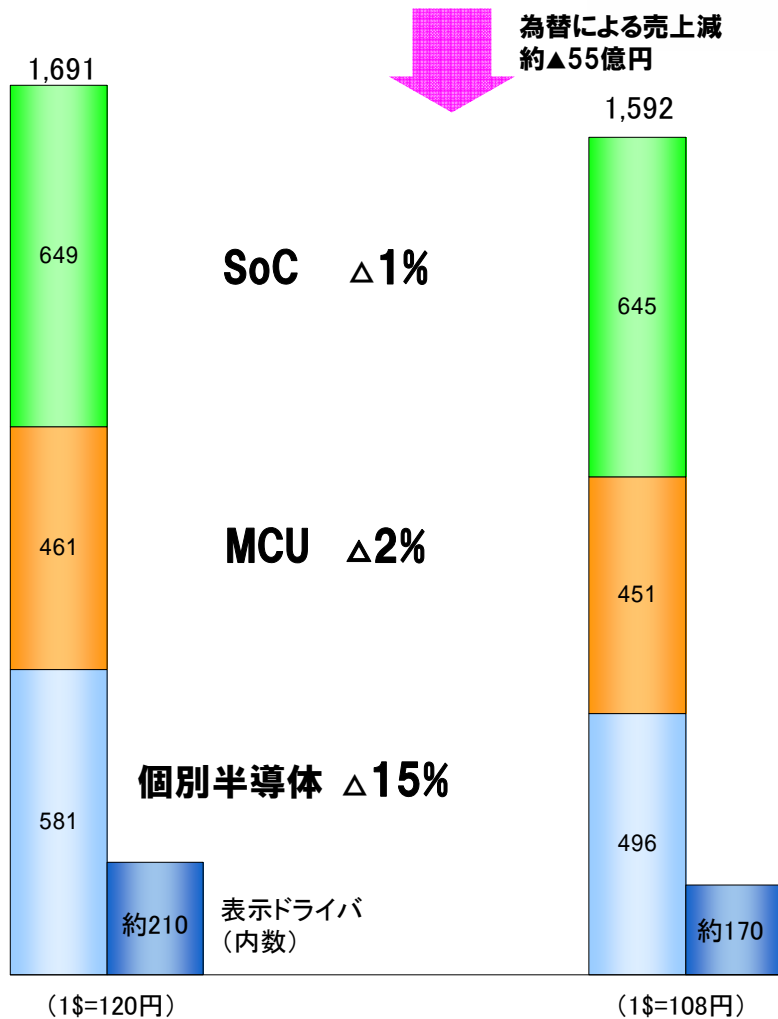


注: 当社は米国会計基準を採用しておりますが、「営業損益」は売上高から売上原価、研究開発費、販売費および一般管理費を差し引いたものです。

第2四半期(7-9月期) 半導体売上高(製品群別) NEC

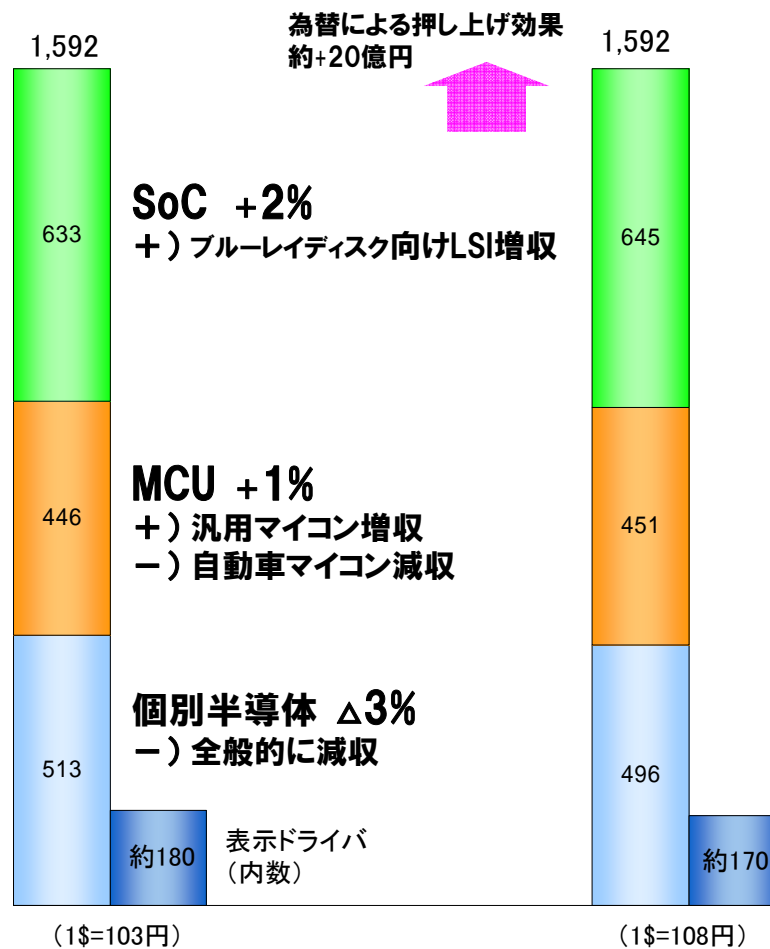
YoY ▲6%

(単位:億円)



QoQ +0%

(単位:億円)



08/3期 第2四半期

09/3期 第2四半期

09/3期 第1四半期

09/3期 第2四半期

第2四半期(7-9月期)営業損益の主な増減要因

YoY

(単位: 億円)

1,691

半導体
売上高

1,592

-) 売上減(為替影響含む)
+) 償却費減

41

営業
損益

SG&A減 +6億円

GP減
△33億円

R&D増△19億円

△5

-) 戦略製品の開発費増

為替による売上減
約▲55億円

(1\$=120円)

08/3期 第2四半期

(1\$=108円)

09/3期 第2四半期

QoQ

(単位: 億円)

1,592

半導体
売上高

+) 原価低減効果
+) 工場稼働増(89%→91%)
-) 償却費増

営業
損益
17

GP増 +30億円

SG&A増 △14億円

R&D増
△38億円

△5

-) 費用発生時期のずれ(1Q→2Q)
-) 戦略製品の開発費増

為替による押し上げ効果
約+20億円

(1\$=103円)

09/3期 第1四半期

(1\$=108円)

09/3期 第2四半期

バランスシート

NEC

(単位:億円)		07/9	08/3	08/9
	現金および現金同等物	1,914	1,655	1,580
	受取手形および売掛金	1,003	964	953
	たな卸資産	802	758	820
	有形固定資産	2,825	2,592	2,570
	その他の資産	336	195	297
	総資産	6,879	6,163	6,220
	支払手形および買掛金	1,308	1,081	1,119
	社債および借入金	1,329	1,166	1,171
	その他の負債	1,579	1,593	1,629
	負債	4,216	3,840	3,920
	少数株主持分	53	52	52
	株主資本	2,611	2,271	2,248
	負債、少数株主持分および資本合計	6,879	6,163	6,220
	D/Eレシオ(グロス)	0.51倍	0.51倍	0.52倍
	株主資本比率	38%	37%	36%

キャッシュ・フロー

(単位：億円)	08/3期	09/3期		
	上期	1Q	2Q	上期
営業活動による キャッシュ・フロー	291	42	146	188
投資活動による キャッシュ・フロー	△188	△109	△125	△234
フリー・キャッシュ・フロー	103	△67	21	△45

I. 2009年3月期 第2四半期 業績概要

II. 2009年3月期 通期業績見通し

09/3期 業績予想

下期・通期営業黒字化を目指す

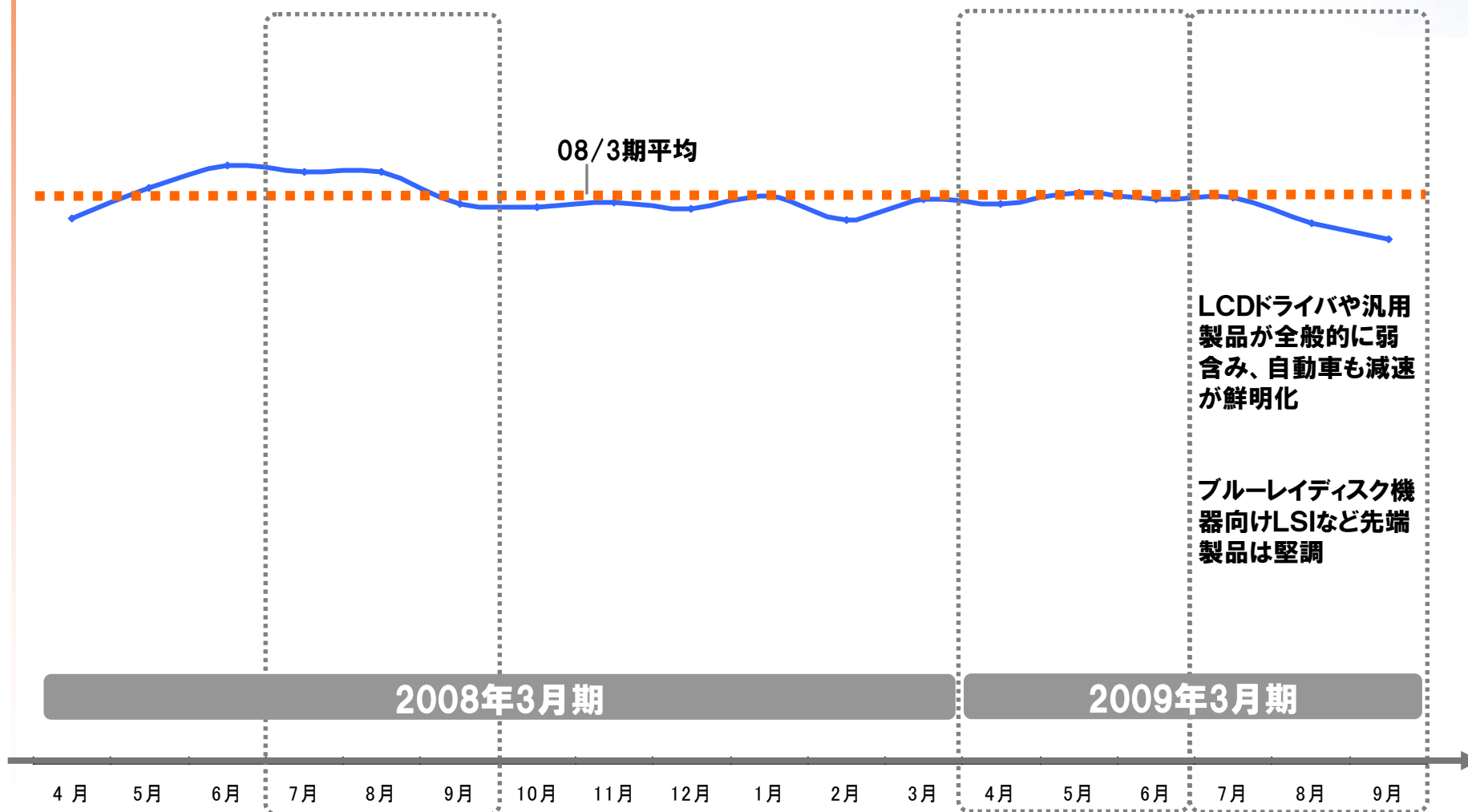
(単位:億円)	08/3期	09/3期								
	年間	上期			下期			年間		
	実績	期初予想 5月14日 時点	実績	差異	期初予想 5月14日 時点	今回予想 10月21日 時点	差異	期初予想 5月14日 時点	今回予想 10月21日 時点	差異
売上高	6,877	3,350	3,336	△14	3,500	約3,300	△約200	6,850	6,600	△250
半導体売上	6,533	3,200	3,184	△16	3,300	約3,100	△約200	6,500	6,300	△200
営業損益	51	30	12	△18	70	0	△約70	100	10	△90
税前損益	△33	0	△0	△0	40	△約40	△約80	40	△40	△80
当期純損益	△160	△20	△19	+1	20	△約60	△約80	0	△80	△80
為替レート										
1US\$=	116円	100円	105円	+5円	100円	105円	+5円	100円	105円	+5円
1Euro=	161円	160円	163円	+3円	160円	145円	△15円	160円	145円	△15円

注1:当社は米国会計基準を採用しておりますが、「営業損益」は売上高から売上原価、研究開発費、販売費および一般管理費を差し引いたものです

注2:予想値は2008年10月21日現在

半導体受注高の推移

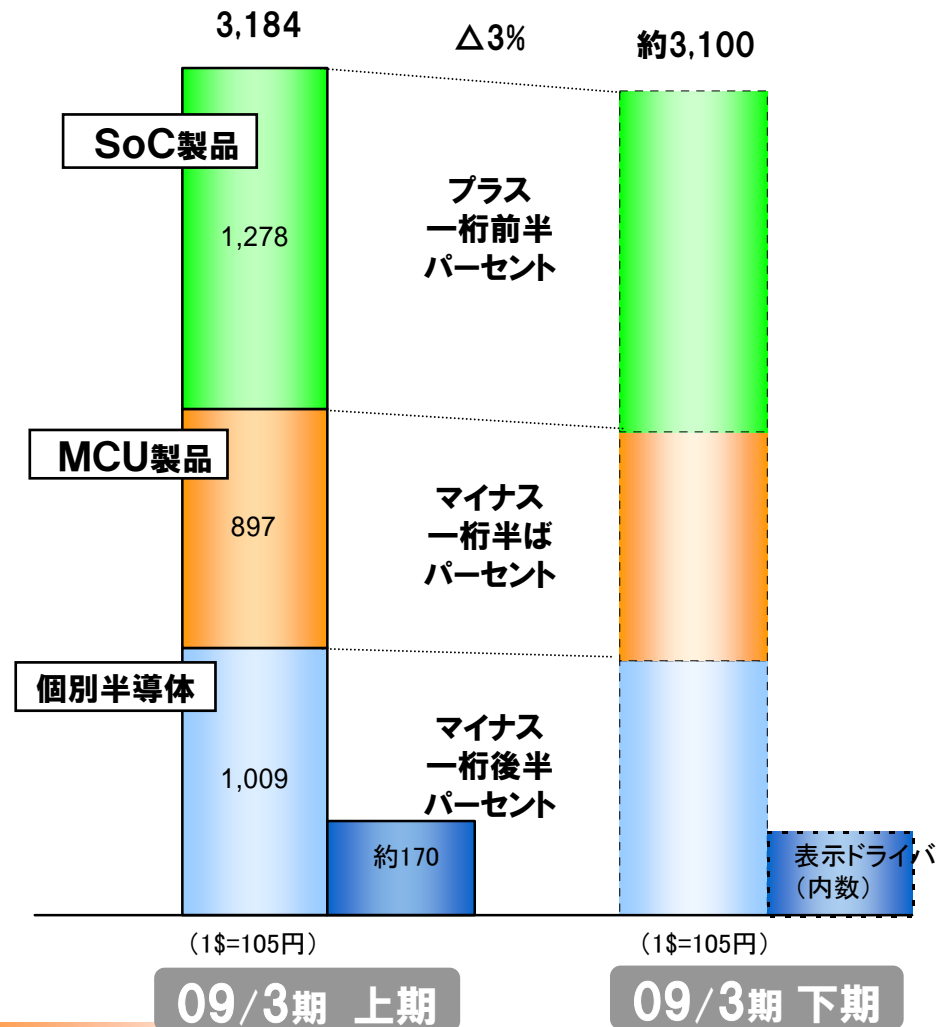
受注（3ヶ月移動平均）



下期 半導体売上高見込み（前期比較）

（億円）

HoH

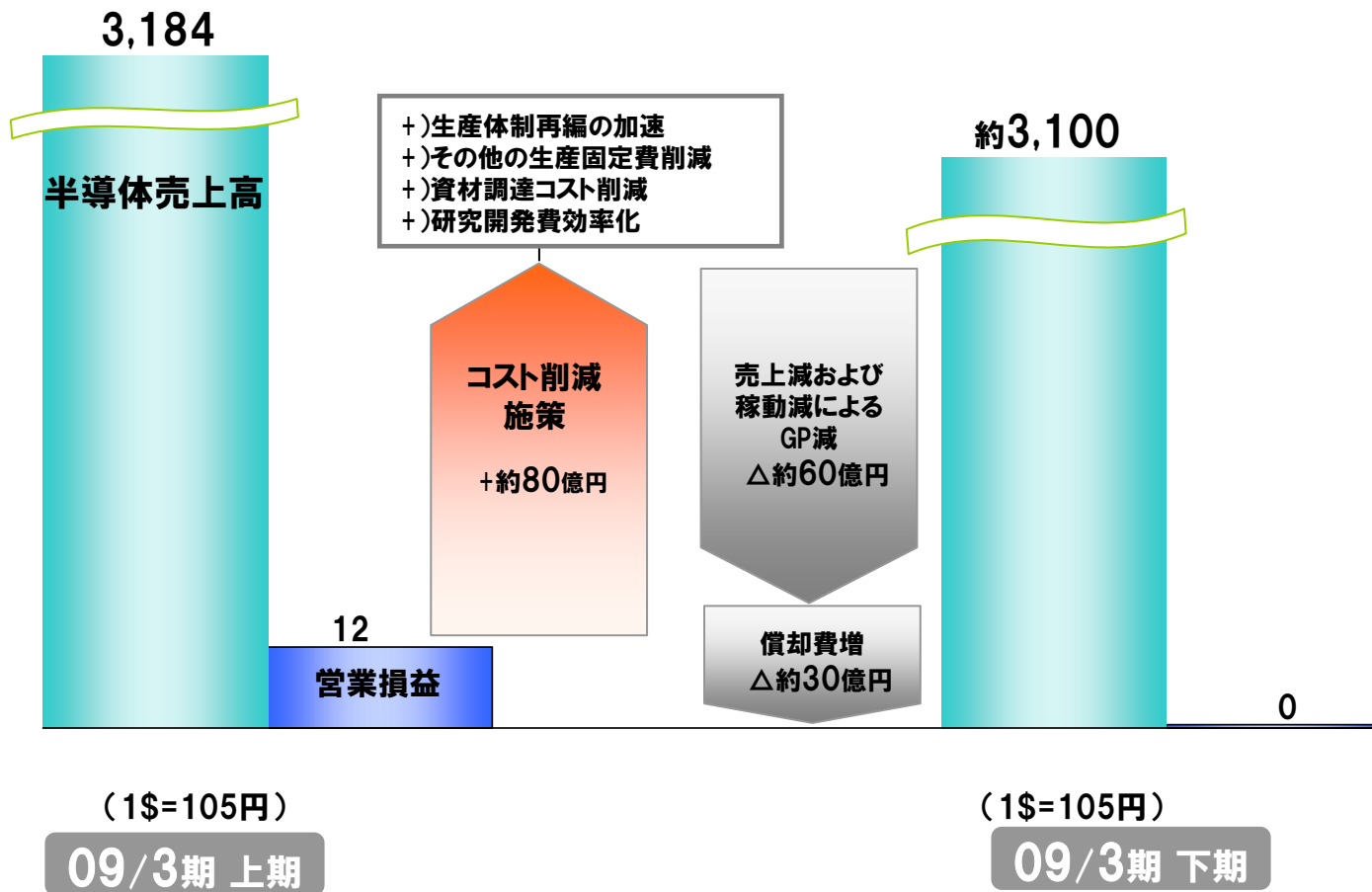


主な変化要因	
SoC製品	+) デジタルAV機器向け“EMMA” -) 一部ASIC製品で減収
MCU製品	-) 自動車向け・汎用とも売上減
個別半導体	-) 分野全般的に減収

下期営業損益の主な増減要因

(単位: 億円)

HoH



下期営業黒字化に向けた主な施策

NEC

生産体制再編の加速をはじめとするコスト削減施策を実施

■ 生産体制再編の加速

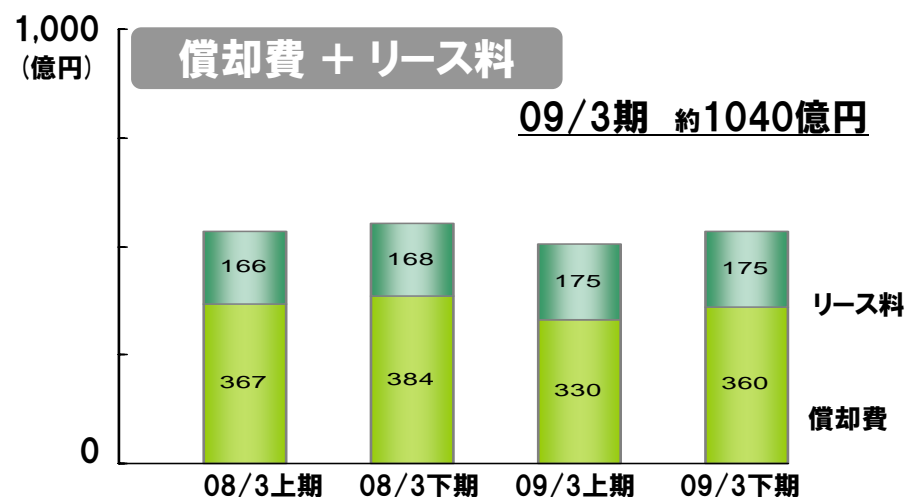
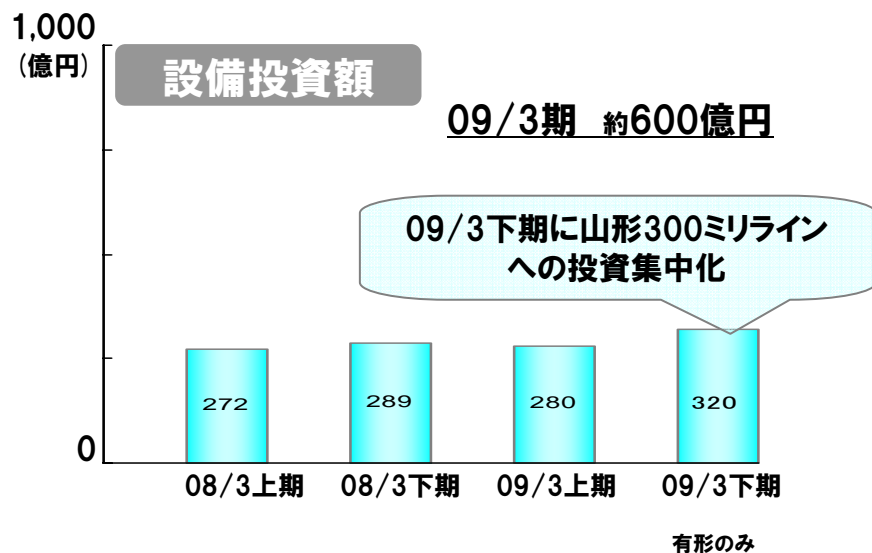
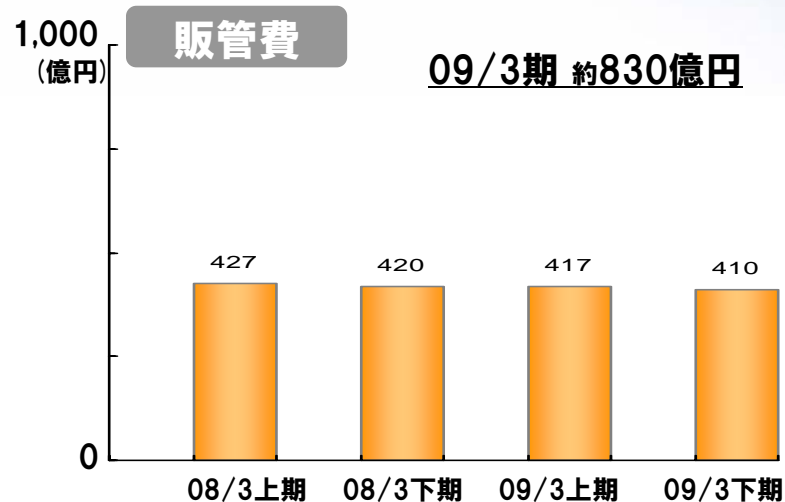
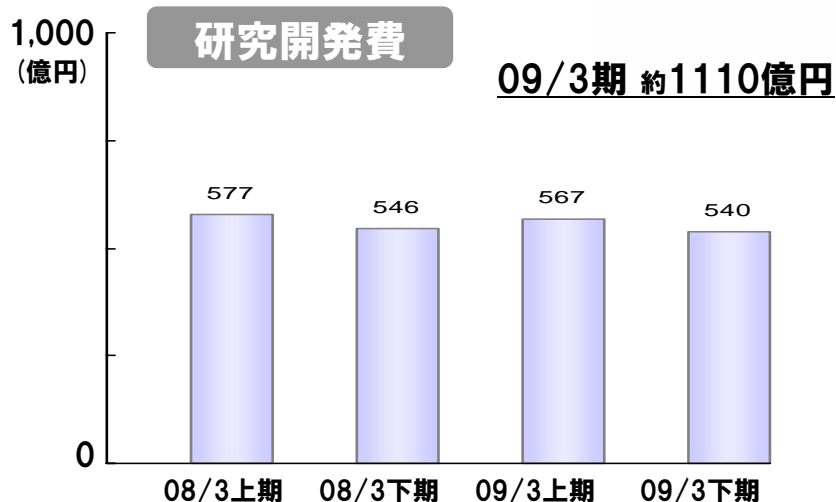
- 山形8インチライン 08年11月閉鎖
(従来は08年12月閉鎖の予定)
- 相模原300ミリライン 08年12月閉鎖
(従来は09年3月閉鎖の予定)

■ 経営効率の改善

- その他の生産関連含む固定費削減
- 資材調達コストの更なる削減
- 研究開発費の効率化

上期比で約80億円のコスト削減効果を図る

主な営業費用と設備投資の推移



償却費・リース料は、原価・研究開発費・販売管理費に含まれます
償却費はキャッシュフロー表ベース

本日のまとめ

事業環境の悪化に伴い、09/3期下期・通期の業績見通しを修正

業績目標は引き下げるものの、追加的なコスト削減施策を実行し、下期・通期での営業黒字化を目指す

- **事業環境が更に悪化することを想定し、より一層のコスト削減施策を検討中**

NEC

NEC Electronics Corporation

(将来予測に関する注意)

本資料に記載されている当社および連結子会社(以下NECエレクトロニクスと総称します。)の計画、戦略および業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、(1)NECエレクトロニクスの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、(2)市場におけるNECエレクトロニクスの製品、サービスに対する需要動向や競争激化による価格下落圧力、(3)激しい競争にさらされた市場においてNECエレクトロニクスが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(4)為替レート(特に米ドルと円との為替レート)の変動等がありますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等により、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。

1. ビジネスハイライト

- 先端プロセス開発での協業
- 注力製品の進捗

2. 分野別売上高推移

最先端プロセス開発での協業

**IBMと32ナノメートル以降の最先端プロセス
開発で協業** (2008年9月17日発表)

- 世界的なプロセス・IPコア共通化の動きに参加

注力ビジネス 進捗状況

DRAM混載LSI

- 採用アプリケーションの拡大 (デジタルAV、携帯電話、通信機器、車載向け等)
- 商談件数の着実な増加と顧客の拡大

EMMA (Enhanced Multi-Media Architecture)

- ブルーレイ関連の新規商談拡大中
- デジタルTV向けEMMA商談の拡大

参考：分野別 半導体売上高

(単位:億円)

